



H2420 芯片级底部填充胶

H2420 是一款单组分，热固化的环氧树脂胶粘剂。本产品专为芯片封装 CSP、Flip-Chip 等制程设计。H2420 使用时填充效果好，固化后可靠性高，热膨胀系数小，电性能优异。

产品描述

产品特性

条目	描述
技术类型	环氧
外观	黑色液体
组分	单组分
固化方式	热固化
应用	底部填充
典型的产品应用	芯片级封装 CSP

产品优点

- 单组份
- 优异的渗透性
- 热膨胀系数小
- 优异的可靠性
- 适用于高精度点胶

产品性能

未固化时性能

条目	典型值	备注
粘度 cps	10000±2000	ASTM D4287, 剪切速率 5 S
填料重量比 %	72%	/
填料平均粒径 um	0.5	/
填料最大粒径 um	2	/
工作时间 天	1	@ 25° C, 25% 粘度上升
流动时间 min	9	GF 基板、50um 间隙、70℃、25mm 长



固化后性能

在推荐的条件下固化：

条目			典型值	备注
物理性能	玻璃化转变温度 (Tg) °C		134	TMA
	热膨胀系数 ppm/°C	Tg 前	25	TMA, 升温速度 5°C/min
		Tg 后	67	
	拉伸剪切强度 MPa		> 6	GB/T 7124 PCB/PCB
	弹性模量 GPa		8.0	GB/T 9341-2008
离子含量	Cl ⁻	ppm	< 10	GB/T 15454-2009
	K ⁻	ppm	< 10	
	Na ⁻	ppm	< 10	
电气性能	体积电阻率	Ω · cm	> 1.0×10 ¹⁵ Ω.cm	GB/T 31838.2-2019

典型的固化性能

固化条件

条目	典型值
热固化	15min 室温升至 100°C 90min@100°C 15min 100°C升至 165°C 120min@165°C

以上固化条件仅是推荐的指南。固化条件（时间和温度）应依据客户经验、应用要求、固化设备、烤箱负载、实际烤箱温度而不同。

使用说明

在使用前必须恢复到室温，在恢复到室温以前请不要打开铝箔包装(建议回温时间大于 2 小时)；不要松开针筒前堵和后盖；针筒包装必须使嘴朝下放置；不可以加热解冻；严禁反复解冻。

本品在 25°C，相对湿度 < 60%的条件下，使用期是 1 天。

点胶使用时基板预热温度建议：70~120°C。

注意事项

有关本产品的安全注意事项，请查阅安全数据资料。

标准包装



- 10ml / 支
- 根据客户要求

产品储存

本产品无毒性、无危险性，遵循标准化学品运输和储存。

将产品存贮于未开封的原装容器内，并存放在干净、干燥的区域。存储信息同时标注于产品外包装标签。

本产品最佳存储条件：-40±2℃，存储期 6 个月。

为防止未使用产品受到污染，请不要将任何材料放回原装容器。本公司不对在前述情况以外的条件下被污染或储存的产品承担责任。更具体的保存期限信息，请咨询 Hanlicon 应用工程师。

注：本文中所含的各种数据仅供参考。对于任何人采用我们无法控制的方法得到的结果，我们恕不负责。自行决定把本产品用在本文中提及的产品应用外，及未采取本文中提及的措施来防止产品在贮存和使用过程中可能发生的损失和人身伤害都是用户自己的责任。本公司明确声明对所有因销售公司产品或特定场合下使用本公司产品而出现的问题，包括针对某一特殊用途的适用性问题，我们不承担责任。公司明确声明对任何必然的或意外损失都不承担责任。建议用户每次在正式使用前都要根据本文提供的数据先做实验。



湖南创瑾科技有限公司

中国湖南省长沙市宁乡经济技术开发区谐园北路

中国长沙智能终端产业园 5 号栋

Tel: +86-731-87827556

www.trumjin.com